

27/09/02
200205858



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

162162

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年10月11日 (11.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/74962 A1

(51) 国際特許分類: C09J 163/00,
7/00, H01L 21/52, 23/14, H05K 3/34

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/02716

(22) 国際出願日: 2001年3月30日 (30.03.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2000-101253 2000年3月31日 (31.03.2000) JP
特願2000-101254 2000年3月31日 (31.03.2000) JP
特願2001-074268 2001年3月15日 (15.03.2001) JP
特願2001-078587 2001年3月19日 (19.03.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富山健男 (TOMIYAMA, Takeo) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウスB-408 Ibaraki (JP). 稲田禎一 (INADA, Teiichi) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウスB-108 Ibaraki (JP). 安田雅昭 (YASUDA, Masaaki) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウスA-305 Ibaraki (JP). 畠山恵一 (HATAKEYAMA, Keiichi) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウスB-209 Ibaraki (JP). 長谷川雄二 (HASEGAWA, Yuuji) [JP/JP]; 〒305-0000 茨城県つくば市筑穂3-15-4 イーグル

ガーデンB101 Ibaraki (JP). 西山雅也 (NISHIYAMA, Masaya) [JP/JP]; 〒300-3254 茨城県つくば市鹿島台5-9 セジュール鹿島台102 Ibaraki (JP). 松崎隆行 (MATSUZAKI, Takayuki) [JP/JP]; 〒299-0125 千葉県市原市有秋台西2-5 C-15-205 Chiba (JP). 宇留野道生 (URUNO, Michio) [JP/JP]; 〒266-0016 千葉県千葉市緑区椎名崎町479 Chiba (JP). 鈴木雅雄 (SUZUKI, Masao) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-18-2 松代レジデンス1203 Ibaraki (JP). 岩倉哲郎 (IWAKURA, Tetsurou) [JP/JP]; 〒300-3261 茨城県つくば市花畑1-15-18 紫峰寮B-408 Ibaraki (JP). 島田 靖 (SHIMADA, Yasushi) [JP/JP]; 〒300-2655 茨城県つくば市島名664 Ibaraki (JP). 田中裕子 (TANAKA, Yuuko) [JP/JP]; 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖2637-1 サンヒル6-102 Ibaraki (JP). 栗谷弘之 (KURIYA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒308-0000 茨城県下館市幸町3-28-12 Ibaraki (JP). 住谷圭二 (SUMIYA, Keiji) [JP/JP]; 〒312-0063 茨城県ひたちなか市田彦1313-2 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 弁理士 津国 肇 (TSUKUNI, Hajime); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TSビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, METHOD FOR PREPARING THE SAME, ADHESIVE FILM USING THE SAME, SUBSTRATE FOR CARRYING SEMICONDUCTOR AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、その製造方法、これを用いた接着フィルム、半導体搭載用基板および半導体装置

(57) Abstract: An adhesive composition characterized in that it comprises (a) an epoxy resin, (b) a curing agent and (c) a high molecular weight compound having a weight average molecular weight of 100,000 or more, wherein, when A represents the total weight of the epoxy resin (a) and the curing agent (b) and B represents the weight of the high molecular weight compound (c), the ratio A/B is more than 1 and not more than 10; an adhesive composition characterized in that the components thereof are separated into a sea phase and island phases in a cross section after curing, wherein, when X represents the area of the sea phase and Y represents the area of the island phases, the ratio X/Y is 0.1 to 1.0; an adhesive film comprising any of the above adhesives formed into a film; an adhesive film for connecting a semiconductor chip with a substrate for carrying a semiconductor or with another semiconductor chip, characterized in that the adhesive film can fix them with a pressure of 0.01 to 0.5 MPa while heating; a substrate for carrying a semiconductor having the adhesive film on the surface thereof to carry a chip; and a semiconductor device which uses the adhesive film or the substrate for carrying a semiconductor.

[続葉有]

WO 01/74962 A1



ACTION